



2026年度 事業戦略説明会

半導体事業本部

2026年5月27日

01	事業概要	P. 3
02	2025年度の振り返り	P. 6
03	2026年度経営計画	P. 8
	市場動向	P. 9
	事業方針・事業計画・重点施策	P.10
	設備投資・研究開発	P.20

01 事業概要

車の電動化、パワエレ機器の小型化、省エネ、CO2削減などに貢献

電装 (*国内 72% / 海外 28%)

電装モジュール



主な用途

電動車



駆動用インバータ、DC/DCコンバータ、
車載エアコン 等

電装ディスクリート



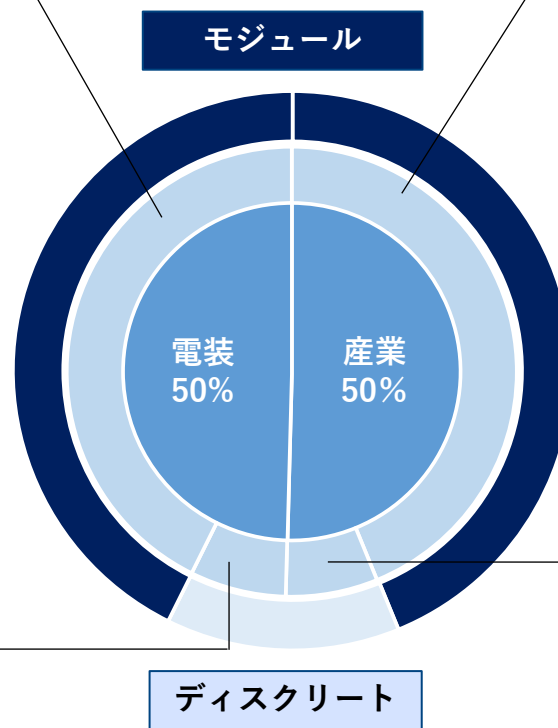
主な用途

電動車
エンジン車



車載充電器、エンジン制御、ブレーキ
制御、ステアリング制御 等

売上高 (2025年度実績)
2,374億円 (*国内 45% / 海外 55%)



産業 (*国内 18% / 海外 82%)

産業モジュール



主な用途



モータードライブ
(インバータ、サーボ
産業ロボット等)



データセンター(UPS 等)



再生可能エネルギー (PCS、蓄電池)

産業ディスクリート、感光体



主な用途



薄型TV



ミニUPS



プリンター

※売上構成比は2025年度実績。
セグメント間の内部取引等を消去・調整する前の金額に基づき算出。

IGBTモジュール世界シェア第3位

- IGBTモジュール市場で世界トップクラスのポジション
- 業界初RC-IGBTを市場展開、国内外の自動車メーカーに採用
- 豊富な市場実績と高信頼性技術の保有

先端チップと高密度実装技術

- 第7、8世代IGBTや第3世代SiC-MOSFETなど、業界トップクラスの低損失性能
- 低損失チップと高密度実装技術を組み合わせた業界最小のモジュール製品
- 特性変動が少なく装置の最適設計が可能

グローバルな顧客サポート

- 国内外のマルチ生産拠点、販売・デザインセンター

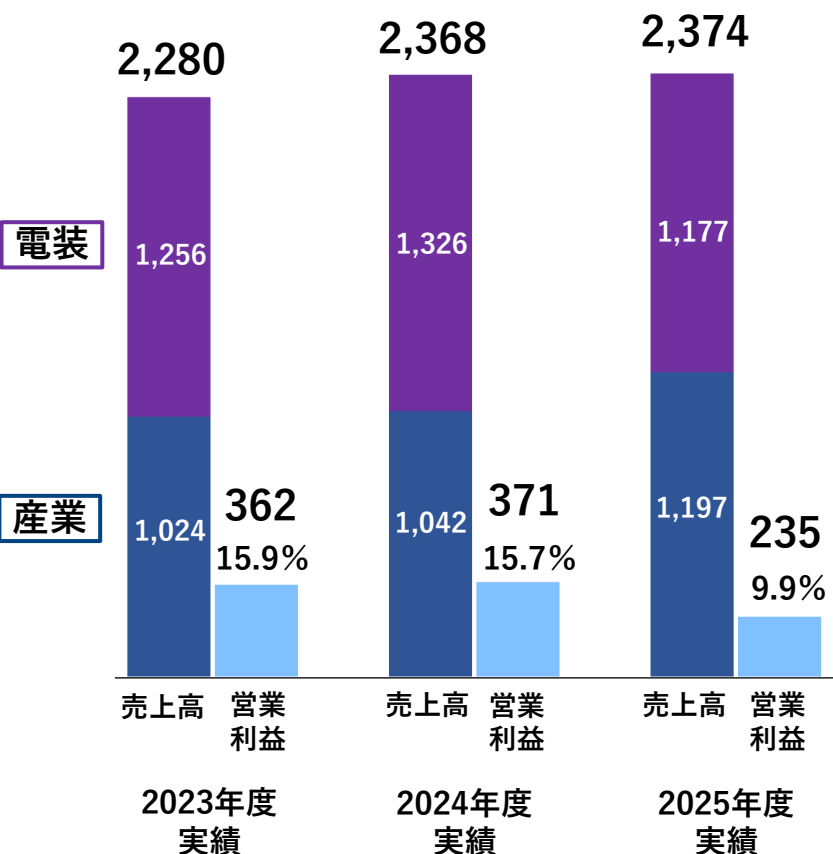
顧客装置・製品への貢献

- 省エネ性能・出力拡大
- 小型化・省スペース化
- 顧客要求品質の確保
- 設計マージンの最適化

02 2025年度の振り返り

サブセグメント別売上高・営業利益

(億円)



主な成果






- ・ SiC前工程の増産投資による売上拡大
生産能力：前年比 2.5倍（富士電機津軽セミコンダクタ）
売上高：前年比 約2倍
- ・ 新製品 量産開始
再エネ向け大容量IGBTモジュール（1.7kV/2.3kV）
電動車向け第3世代SiCチップ、小型RC-IGBTモジュール
- ・ 第8世代IGBTモジュール サンプル展開開始

課題

- ・ 電装分野の売上拡大
新規スペックイン、新規顧客開拓の推進
- ・ 収益力の向上
- ・ 競争力のある新製品の開発

03 2026年度 経営計画

- 産業：モータードライブ向けで需要が拡大
- 電装：電動車全体で継続伸長する見込み

事業分野	当社対象市場動向（2026年度）		2025 → 2026年度
産業	モーター ドライブ※1	AI向け半導体好調により半導体製造装置や産業ロボット向けが 需要増。NC工作機械は自動化・効率化の需要が継続	
	再エネ	太陽光発電は鈍化するが、風力発電及び蓄電池(ESS※2)向けは 堅調見込み	
	民生	省エネ規制によるルームエアコンの買替え需要、企業のDX推 進及び5G普及による通信機器の需要増で緩やかに伸長	
電装	電動車	電気自動車(BEV)、ハイブリッド車(HEV/PHEV)共に増加が 継続し、2桁成長の見込み	
	エンジン車	減少傾向は継続	

※1 モータードライブ: インバータ・サーボ、NC工作機械、産業ロボット等

※2 ESS: Energy Storage System

事業方針

成長分野への確実なスペックインと新規顧客の開拓
SiCの需要拡大に合わせた生産体制の構築

重点施策

■ 売上拡大と新規スペックインの強化

- 産業分野：モータードライブ、再エネ分野を中心に拡販
- 電装分野：新規顧客開拓と確実なスペックイン

■ 競争力のある新製品開発

- 次世代SiCモジュール、SiC 8インチ化
- 第8世代IGBTモジュール

■ ものつくりの強化

- 前工程： 需要に対応したSiCの生産能力増強と第8世代IGBTの量産対応
小口径生産ラインの縮小
- 後工程： 新製品の量産立上げと需要増に対応した生産能力増強
 - ・ 産業向け第7、8世代IGBTモジュール、電装向けSiCモジュール（新製品）

中長期的な業績拡大に向け、2026年度は成長準備フェーズ

営業利益率

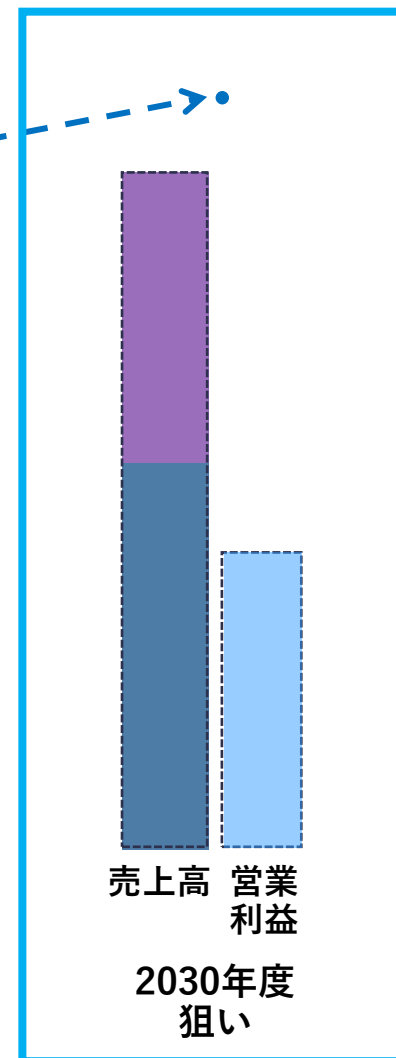
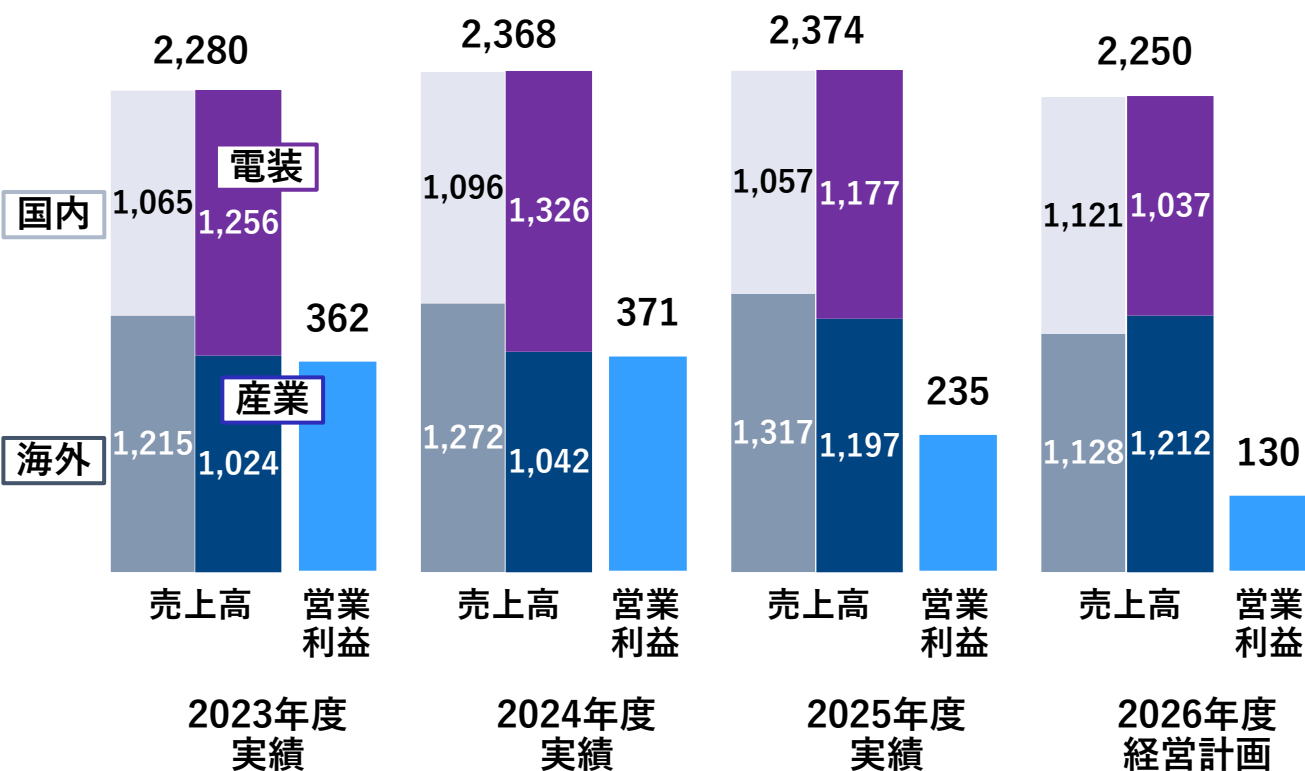
15.9%

15.7%

9.9%

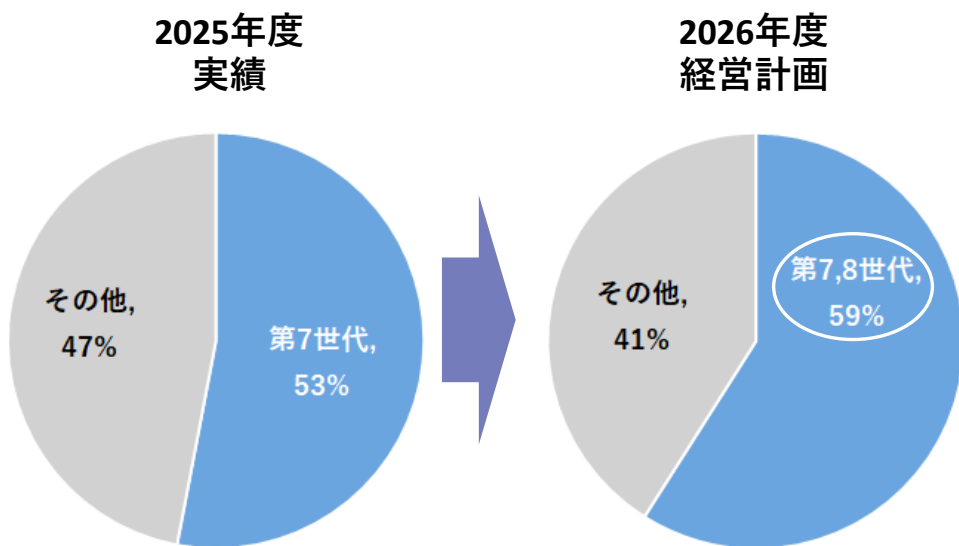
5.8%

(億円)



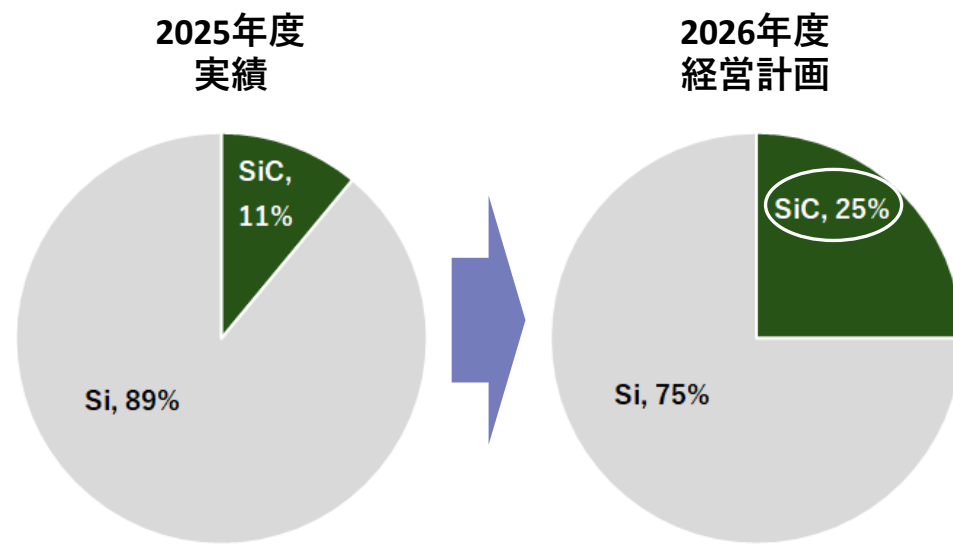
- 産業モジュール：第7、8世代IGBTの売上比率は約60%となる見通し
- 電装モジュール：SiC売上比率は25%へ拡大

産業モジュール売上構成比率



第7、8世代へのシフト

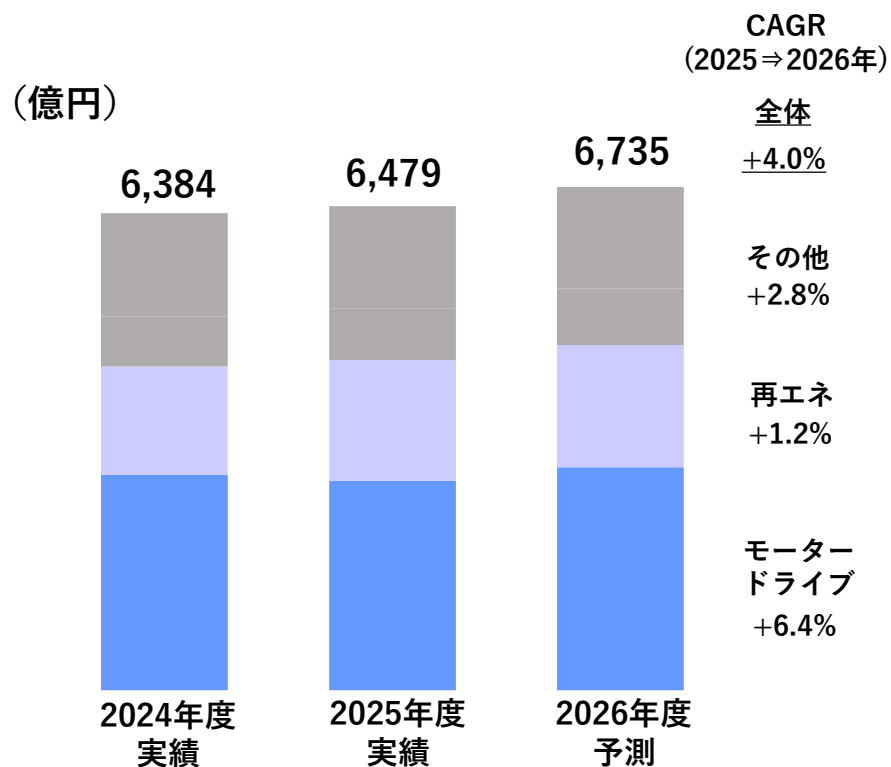
電装モジュール売上構成比率



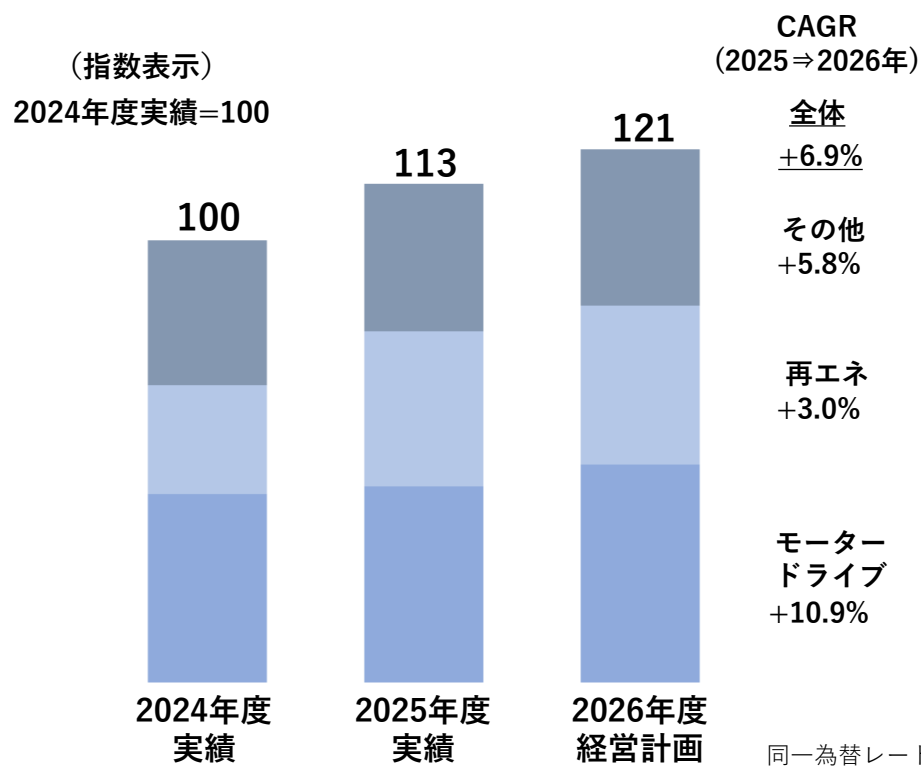
SiC比率の拡大

- 市場はモータードライブが牽引し全体で+4%の伸長を見込む
- 新製品拡販により市場伸長率以上に売上を拡大

当社対象 産業モジュール市場



産業モジュール売上推移



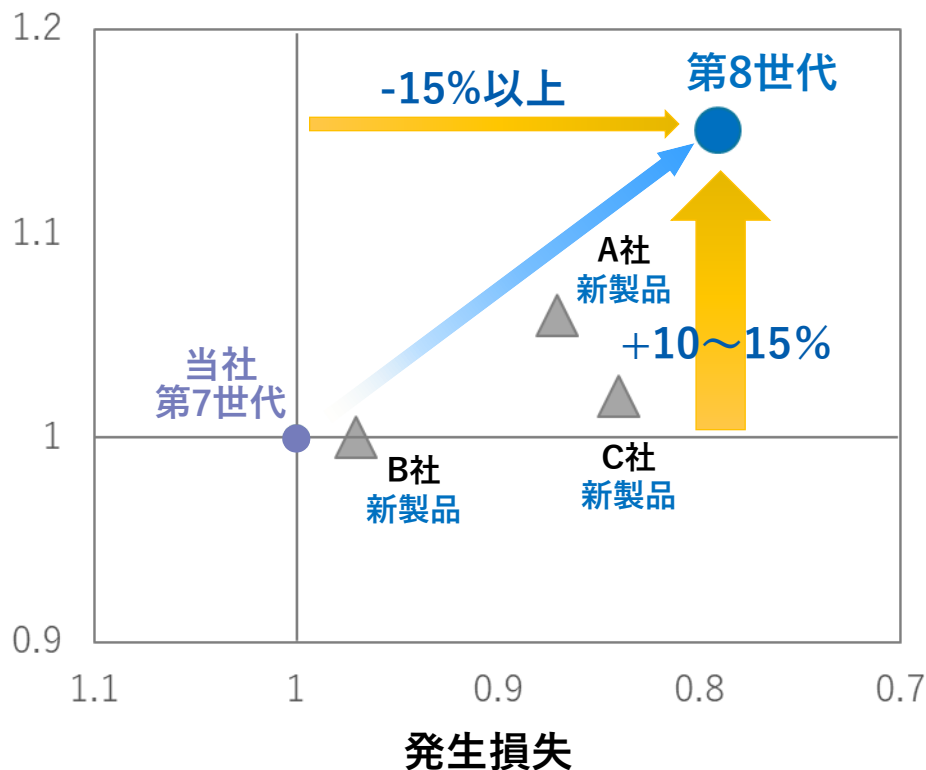
出典元：調査会社DATAを基に弊社独自推定

※ モータードライブ：インバータ、サーボ、NC工作機械、産業ロボット等
 ※ その他：電鉄、民生、DC(電源、空調) 他

- 性能向上（発生損失低減）により同一パッケージで定格電流を拡大
- 装置の小型化、システムコストダウンに貢献

特性優位性

- 当社第7世代比15%以上の発生損失低減により、競合の新製品に対して高出力を実現

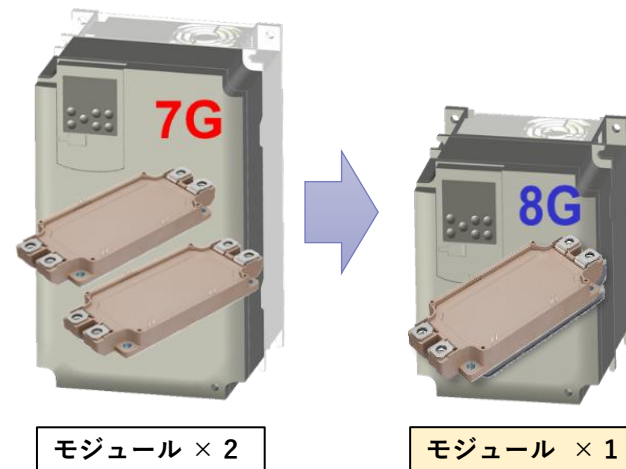


※競合特性は当社測定結果

インバータ搭載事例（従来品比）

- 同一パッケージでの定格電流を拡大
($\sim 1200\text{V}/800\text{A} \Rightarrow \sim 1200\text{V}/1000\text{A}$)
- 装置の小型化とシステムのトータルコストダウンが実現可能


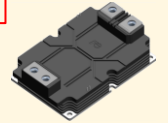

(適用例)
同容量インバータで小型化を実現 (-20~30%)



上市時期

2026年度3Q～順次 量産開始

再エネ、DC等の顧客装置に向け最適なモジュール製品で差別化

1200V／1700V定格	～600A	800A	1000A	1200A	1500A～ 1800A
既存  中容量 モジュール					
新製品  新中容量 モジュール					
既存  大容量 モジュール					

製品特長

- 中容量と大容量の中間領域に最適な新中容量モジュールを開発
（当社独自パッケージ製品で差別化）
- フットプリントサイズ-25%小型化
（大容量モジュール比）
- パッケージ内部の低インダクタンス化※
（ $\leq 10\text{nH}$ ）によりSiCチップ搭載にも対応

※インダクタンス：この値が大きくなるとスイッチング損失やノイズが増大

サンプル展開時期：2026年8月～

- 新規顧客2社の商談を獲得
- 拡販活動を継続推進し、28年度以降の売上拡大を図る

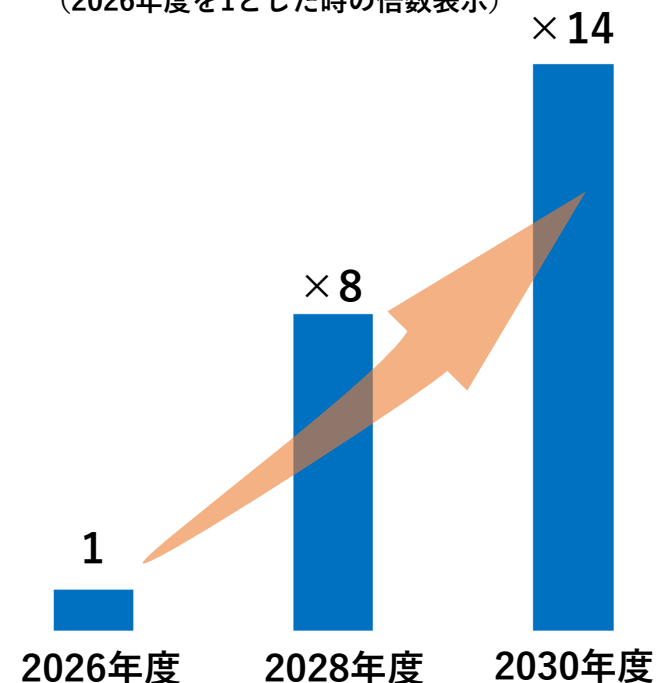
電動車向け IGBT, SiCの新製品採用計画(2024年度以降採用案件)

エリア	顧客	<div>IGBT製品</div> <div>SiC製品</div> <div>新規採用中</div> <div>保守移行</div>		
		26年	27年	28年以降
国内	A社	★		★
	B社	2025年度 受注確定 ★		★
	C社	★		
	D社	★		
	K社	2025年度 受注確定 ★		
欧米	E社			
	F社			
	G社	★		★
	J社			★
	L社(新)			★
中国 アジア	H社			
	I社		★	★
	M社(新)	★		

★：2026年度以降採用案件

新製品商談規模 (※2026年度以降採用案件商談)

(2026年度を1とした時の倍数表示)

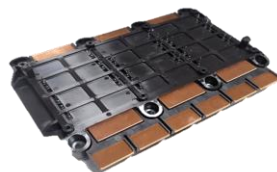


- 薄型パッケージの新製品をラインアップ化し新規顧客開拓を推進
- 顧客装置の小型化、低コスト化に貢献

SiCモジュール（高出力用）

- 立体配線技術により小型化・薄型化を実現
- SiCの高速スイッチング特性を活かすため、モジュール内部のインダクタンス*を大幅低減

従来品比
小型・薄型：-49%（体積比）
低インダクタンス：-80%（ $L_{s24} \rightarrow 5nH$ ）



外形寸法：W167 x D111 x H16mm

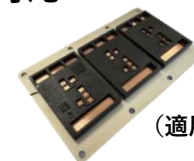
インバ-タ出力	330kW
モジュール定格（1200V）	660A
適用クラス	大型車
	スポーツ車

上市時期

2026年度3Q～量産開始

SiCモジュール（次世代 薄型パッケージ）

- 同一パッケージで幅広い定格を系列化
- モジュールの組合せにより多様なインバータ回路構成に対応
- BOSCH社※と互換パッケージの提供により、お客様のマルチソース要求に対応



（適用例：2in1×3）

※Tier 1 メーカー（独）

外形寸法（カードサイズ）：W63 x D45 x H6mm

インバ-タ出力		100kW	200kW	300kW以上
モジュール定格（2in1×3）	1200V	200A	520A	～900A
	750V	490A	900A	---
適用クラス		小型車	中型車	大型車

サンプル展開：2026年度3Q～

- 需要に対応したSiCの生産能力増強と量産対応、第8世代IGBTの生産開始
- Si 6インチ以下の小口径生産ライン縮小と8インチ化へのシフト
(マレーシアの小口径ラインを25年度閉鎖、26年度8インチへ集約)



松本

前工程のマザー工場

- ・ SiC 6インチ生産開始 (2026年3Q～) 及び能力増強
- ・ SiC 8インチラインの量産準備
- ・ Si小口径ラインの縮小



山梨

Si 8インチ生産

- ・ 電動車向けIGBT
- ・ 第8世代IGBT生産開始 (2026年2Q～)



津軽

SiC 6インチ生産



マレーシア

Si 8インチ生産

- ・ 産業向け第7世代IGBT

新製品の量産立上げと需要増に対応した生産能力増強



国内（3拠点）

組立製品のマザー工場
国内顧客向け製品の生産拠点

- ・ 電動車向け小型IGBTモジュール増産及びSiCモジュール生産開始（2026年3Q～）
- ・ 産業用大容量モジュールの能力増強（前年度比 約3倍）
- ・ 第8世代IGBTモジュール生産開始（2026年度3Q～）



フィリピン

ディスクリート製品及びエアコン向けモジュールの主力拠点



中国（深セン）

中国顧客向け産業IGBTモジュール生産拠点

- ・ 第7世代IGBTモジュールの能力増強（需要増対応、前年度比 約30%増）

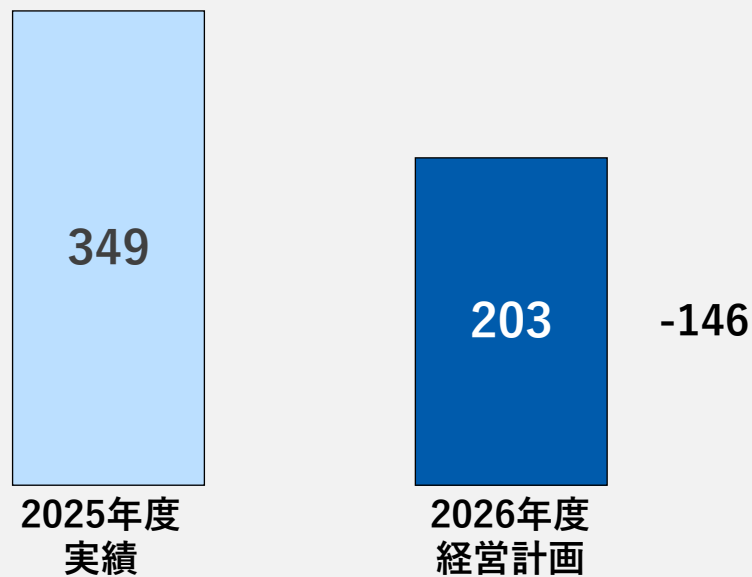


マレーシア

欧米顧客向け産業IGBTモジュール生産拠点

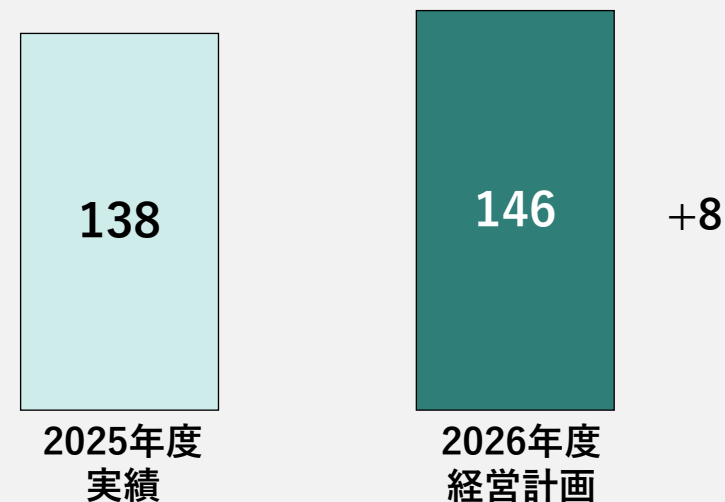
- ・ 第7世代IGBTモジュールの能力増強（需要増対応、前年度比 約20%増）

設備投資（億円）



- 前工程
 - ・ 特高受電設備 等の更新
 - ・ SiC生産能力増強
- 後工程 生産能力増
 - ・ 産業及び電装向けモジュール（新製品対応）
- 開発
 - ・ SiC 8インチライン

研究開発（億円）



- 新製品開発の推進
 - ・ 8インチ SiC開発
 - ・ 第3世代、第4世代 SiC開発
 - ・ 第8世代 IGBT開発

※研究開発費はテーマに応じてセグメントに分類したもので、決算短信記載の数値と異なります。

1. 本資料及び本説明会に含まれる予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があります。弊社、将来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。
2. 本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社の株式の売買を勧誘するものではありません。
3. 目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。